



FIDURA

Private Equity Fonds

FIDURA-Fonds-Beteiligung mechatronic systemtechnik und ProTec Carrier Systems ergänzen sich auf dem Gebiet des Handling von dünnen Substraten

(Villach/Österreich, 20.April 2011) Die beiden Spezialisten für Dünnyafer-Handlingsysteme mechatronic systemtechnik und ProTec Carrier Systems (PCS) intensivieren ihre Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Handling von dünnen Substraten mittels der T-ESC®-Technologie.

Die T-ESC®-Technologie basiert auf der Eigenschaft, durch ein elektrostatisches Feld auf Materialien mit bereits geringer Leitfähigkeit eine elektrische Kraftwirkung auszuüben. Die von PCS entwickelten mobilen elektrostatischen Carrier (T-ESC®) können ein solches Feld aufbauen und vor allem dünne Substrate (< 50µm) für einen langen Zeitraum (bis zu 50 Stunden) mit Hilfe der elektrostatischen, sog. Coulomb-Kraft festklemmen. Das Lösen nach Prozessende dauert nur kurz und hinterlässt keinerlei Spuren an dem fixierten Substrat. Organische Reste durch die Nutzung von Tapes oder durch Bonden – und damit zusätzliche Reinigungsschritte – werden vermieden. Durch die T-ESC®-Technologie werden das sichere Handling und der Transport von dünnsten Substraten der Halbleiter-, Photovoltaik- und Displayindustrie auch während der einzelnen Prozessschritte, insbesondere bei Vakuum und hohen Temperaturen, gewährleistet.

Die Anwendungen, bei denen die Vorteile von dünnen Substraten genutzt werden können, z.B. die 3-D-Integration, stehen an der Schwelle der Massenfertigung. Die Halbleiterhersteller fordern deshalb voll automatisierte Systeme, mit denen auch dünne Wafer sicher transportiert und prozessiert werden können. Hierzu haben PCS und mechatronic systemtechnik das voll automatische Chucking/De-Chucking System ACU 3000 entwickelt, das nun bei LFoundry in Landshut, Deutschland, im Rahmen eines von der EU geförderten Projektes („SEAL“) umfassend erprobt und demonstriert werden soll.

Das System ACU 3000 ist in der Lage, bis zu 120 Carrier-Pakete pro Stunde zu erzeugen, d.h. einen Wafer auf einem Carrier mit Hilfe der elektrostatischen Haltekraft zu fixieren bzw. zu lösen. Die elektrostatische Lade-/Entladeeinheit der ACU 3000 steht auch als einzelnes Modul zur Verfügung und kann somit auf Grund der standardisierten Schnittstellen auch in andere Systeme, z.B. Prozesstools, integriert werden. Diese werden dadurch in die Lage versetzt, dünne Substrate zu verarbeiten, ohne system- oder prozessrelevante Veränderungen vornehmen zu müssen.

„Die Zusammenarbeit mit mechatronic systemtechnik führt zu einer idealen Symbiose und verschafft beiden Unternehmen entscheidende Wettbewerbsvorteile“, erklärt Roland Raschke, Geschäftsführer der PCS GmbH. „Ein großer Vorteil der T-ESC®-Technologie liegt darin, dass Kunden dünne Substrate einfach und ohne große Investitionen mit ihrem Equipment verarbeiten können“, ergänzt Walter Schober, CEO der mechatronic systemtechnik gmbh.

Über die Mechatronic Systemtechnik GmbH

Die mechatronic systemtechnik gmbh mit Sitz in Villach (Österreich) entwickelt, fertigt und vermarktet seit 1998 Spezialmaschinen für die Halbleiterindustrie und verfügt über ein weltweit einzigartiges Produktportfolio für das Handling von Silizium-Dünnscheiben. Verwendung finden diese dünnen Scheiben aus Halbleitermaterial vor allem im permanent wachsenden Markt für Unterhaltungselektronik, z.B. in Handys, MP3-Playern, Digitalkameras oder Camcordern. Mit seinen patentierten Dünnscheiben-Handling-Systemen verfügt mechatronic systemtechnik über ein klares Alleinstellungsmerkmal am internationalen Markt. mechatronic systemtechnik Handling-Systeme transportieren Wafer berührungslos und zu 100 Prozent automatisiert. Dazu wurden unterschiedliche Verfahren und Instrumente entwickelt, die je nach Kundenanforderungen eingesetzt werden, wie die Bernoulli-(Vakuum-)Technologie oder der elektro-statische Greifer. Dies bedeutet einen technologischen Vorsprung von mindestens vier Jahren. Zu den internationalen Kunden zählen führende Unternehmen wie z.B. Infineon, NXP, Nikon, Rudolph, TSMC, UMC, ASE, STATS ChipPAC, ...

Kontakt:

Martina Lintner
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Mechatronic Systemtechnik GmbH
Tiroler Straße 80
A-9500 Villach
Tel.: +43-(0)4242-33999-0
E-Mail: martina.lintner@mechatronic.at
Internet: www.mechatronic.at

Über ProTec Carrier Systems GmbH (PCS)

PCS ist ein junges, hochinnovatives Unternehmen, das sich mit der Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Systemen und Komponenten zum Transport inklusive der Prozessierung von dünnen und ultradünnen Substraten beschäftigt. Die Anwendungen sind für die Halbleiter-, Solar- und Displayindustrie mittels der weltweit patentierten Transfer-Elektro-Statistischen Carrier (T-ESC®)-Technologie vorgesehen. Schwerpunkt sind hierbei Anwendungen, bei denen die herkömmlichen temporären Bondingsysteme versagen oder nicht ausreichend funktionieren. Einige Prozesse sind durch die T-ESC® Technologie für dünne Substrate erst realisierbar, wie z.B. das Back-Side-Gas-Cooling. Das Unternehmen mit Sitz in Siegen, Deutschland, wurde 2008 gegründet.

Kontakt:

Udo Lorenberg
ProTec Carrier Systems GmbH
Birlenbacher Strasse 19-21
D-57078 Siegen
Telefon +49-(0)271-89041-0
Telefax +49-(0)271-8904119
Email: u.lorenberg@protec-carrier.com
Internet: www.protec-carrier.com

FIDURA Capital Consult GmbH
Bavariaring 44, 80336 München
Tel.: +49 (0)89 / 23 88 98 - 0, Fax: +49 (0)89 / 23 88 98 -29
e-mail: info@fidura-fonds.de, web: www.fidura-fonds.de



Über die FIDURA Capital Consult GmbH und die FIDURA Private Equity Fonds

Mit einem platzierten Fondsvolumen von annähernd 100 Millionen Euro gehört das Münchner Emissionshaus FIDURA Capital Consult GmbH zu den führenden Anbietern von direkt investierenden Private-Equity-Publikumsfonds in Deutschland. Die FIDURA Private-Equity-Fonds investieren direkt in wachstumsorientierte mittelständische Unternehmen und eröffnen Normalanlegern den Zugang zur renditestarken Anlageklasse Private Equity. Die Anleger der FIDURA Private-Equity-Fonds profitieren vom hohen Renditepotenzial innovativer Unternehmen. Das aktuelle Angebot, der FIDURA Rendite Sicherheit Plus Ethik 3 Fonds, ist darüber hinaus der einzige öffentlich angebotene Private-Equity-Fonds mit festen ethischen Beteiligungskriterien in Deutschland. Die FIDURA Fonds finanzieren ihre Beteiligungen ausschließlich über Eigenkapital und sind daher nicht auf Bankkredite angewiesen. Daneben ist keine der Beteiligungen der FIDURA Private-Equity-Fonds börsennotiert, weshalb auch keine direkte Abhängigkeit von eventuellen Börsenturbulenzen vorhanden ist. Auch bei den Beteiligungsunternehmen selbst achtet das FIDURA Management auf eine solide Gesamtfinanzierung, bei der keine unverhältnismäßig hohen Abhängigkeiten von Banken gegeben sind. Gleichzeitig bieten die FIDURA Fonds optional die Möglichkeit der Kapitalabsicherung, wodurch ein Höchstmaß an Sicherheit für das Anlegerkapital erreicht wird. Die Absicherungsstrategie der FIDURA Fonds basiert auf einer engen Kooperation mit der angelsächsischen Versicherungsgesellschaft Canada Life, deren Anlagekonzept strikt auf Risikovermeidung ausgerichtet ist und dank eines Glättungsverfahrens („Smoothing“) zeitweilige Wertverluste durch Gewinne aus den Vorjahren ausgleichen kann.

Kontakt:

Dipl.-Ing. Ingrid Weil
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
FIDURA Capital Consult GmbH
Bavariaring 44
D-80336 München
Tel.: +49 (0)89 / 23 88 98-15
Fax: +49 (0)89 / 23 88 98-29
E-Mail: ingrid.weil@fidura.de
Internet: www.fidura-fonds.de